(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2006 年12 月7 日 (07.12.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/129630 A1

(51) 国際特許分類:
C08G 59/40 (2006.01) *H01L 21/60* (2006.01)
H01L 21/56 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/310722

(22) 国際出願日: 2006 年5 月30 日 (30.05.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2005-159900 2005 年5 月31 日 (31.05.2005) JP
特願2005-159921 2005 年5 月31 日 (31.05.2005) JP
特願2005-278417 2005 年9 月26 日 (26.09.2005) JP
特願2006-050174 2006 年2 月27 日 (27.02.2006) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 桂山 悟 (KATSURAYAMA, Satoru) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 坂本 有史 (SAKAMOTO, Yushi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 光田 昌也 (KODA, Masaya) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川２丁目５番８号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 園田 吉隆, 外 (SONODA, Yoshitaka et al.); 〒1630453 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 新宿三井ビル５３階 園田・小林特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) **Title:** ENCAPSULATING RESIN COMPOSITION FOR PREAPPLICATION, SEMICONDUCTOR DEVICE MADE WITH THE SAME, AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) **発明の名称:** プリアプライド用封止樹脂組成物、それを用いた半導体装置及びその製造方法

(57) **Abstract:** An encapsulating resin composition for preapplication which comprises (a) an epoxy resin and (b) a hardener having flux activity and has a tackiness in the B-stage of 0-5 gf/5 mmD and a melt viscosity as measured at 130°C of 0.01-1.0 Pa·s; and a preapplied encapsulating part including the composition and a semiconductor device made with the composition. The resin composition is less apt to cause air inclusion during the temporary mounting of a semiconductor chip and is excellent in workability and reliability.

(57) 要約: （ａ）エポキシ樹脂と、（ｂ）フラックス活性を有する硬化剤とを含有し、Ｂ－ステージ化後のタック値が０ｇｆ／５ｍｍφ以上５ｇｆ／５ｍｍφ以下であり、かつ、１３０℃における溶融粘度が０．０１Ｐａ・ｓ以上１．０Ｐａ・ｓ以下であるプリアプライド用封止樹脂組成物、それを用いたプリアプライド封止部品及び半導体装置、並びにその製造方法が開示される。該樹脂組成物は半導体チップの仮搭載時において空気巻き込みが少なく、作業性や信頼性に優れる。

WO 2006/129630 A1